证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2020-006
债券代码：124004 债券简称：中京定转
债券代码：124005 债券简称：中京定 02

惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于 2020 年 2 月 28 日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知》；2020 年 3 月 6 日，公司第四届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)以现场及通讯方式召开。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，公司监事列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真自查、逐项论证，公司符合现行非公开发行 A 股股票的有关规定，具备非公开发行 A 股股票的条件。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

同意批准公司以非公开方式向特定对象发行不超过 118,000,000 股人民币普通股(A 股)股票，募集资金金额不超过 120,000 万元人民币(含本数)，本次非公开发行的具体方案如下：

(一)发行股票种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)发行方式和发行时间

本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A 股)的方式，公司将在取得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为包括杨林先生在内的不超过 35 名的特定对象。其中，杨林先生认购金额不低于 5,000 万元。

除杨林先生以外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

除杨林先生以外其他发行对象由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行中请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会的相关规定，根据申购报价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若相关法律、法规和规范性文件或证券监管机构的监管要求对上市公司非公开发行股票的发行对象另有规定的，从其规定。

本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式认购。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)定价基准日、定价原则及发行价格

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的定价原则为发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价 = 定价基准日前二十个交易日股票交易总额 ÷ 定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生分配现金股利、分配股票股利或资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价将做出相应调整。调整公式如下：

分配现金股利：P1=P0-D

分配股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0 为调整前发行底价，每股分配现金股利为 D，每股分配股票股利或资本公积转增股本数为 N，调整后发行底价为 P1。

本次非公开发行的最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行中请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会的相关规定，根据申购报价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。杨林先生接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)发行数量

本次非公开发行的发行数量不超过 118,000,000 股(含本数)，未超过本次非公开发行前公司总股本的 30%。

若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间发生分配现金股利、分配股票股利或资本公积转增股本等除权、除息事项，公司将根据具体情况对本次非公开发行的发行数量上限做出相应调整。

本次非公开发行的最终发行数量由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行中请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会的相关规定，根据申购报价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)限售期

本次非公开发行完成后，杨林先生认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

全体发行对象所认购本次非公开发行的股份因公司分配股票股利或资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。全体发行对象因本次非公开发行所获得的股份在上述限售期届满后，需遵守中国证监会及深交所等证券监管机构的相关规定。若相关法律、法规和规范性文件或证券监管机构的监管要求对发行对象所认购股份限售期及限售期届满后转让股份另有规定的，从其规定。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)募集资金数量及用途

本次非公开发行的募集资金总额不超过 120,000 万元(含本数)，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	拟投资总额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
1	珠海富山高密度印制电路板(PCB)建设项目(1-A 期)	163,800	120,000

本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入，并在本次募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，不足部分将由公司自筹解决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八)本次非公开发行前的滚存利润安排

本次非公开发行前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九)上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十)决议有效期

本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨林先生逐项进行了回避表决。

公司独立董事对该项关联交易进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会逐项审议，并且需经中国证监会核准后方可实施。

三、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

针对本次非公开发行，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司编制了《惠州中京电子科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。

关联董事杨林先生回避表决。

公司独立董事对该项关联交易进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司与杨林先生签署附生效条件的 < 股份认购协议 > 的议案》

根据《实施细则》的相关规定，公司与杨林先生签署了附生效条件的《惠州中京电子科技股份有限公司与杨林关于惠州中京电子科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议》。

关联董事杨林先生回避表决。

公司独立董事对该项关联交易进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

鉴于公司实际控制人杨林先生拟认购本次非公开发行的部分股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，杨林先生认购本次非公开发行的股份构成关联交易，需履行公司关联交易审批程序。

关联董事杨林先生回避表决。

公司独立董事对该项关联交易进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于提请公司股东大会批准杨林先生免于以要约方式增持公司股份的议案》

截至 2020 年 2 月 28 日，杨林先生为公司实际控制人，控制公司 35.03%的股份。根据公司本次非公开发行方案，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，且不超过 118,000,000 股人民币普通股(A 股)股票，募集资金金额不超过 120,000 万元人民币(含本数)，杨林先生承诺认购金额不低于 5,000 万元。若以本次非公开发行股份数量的上限和杨林先生认购的股票数量下限测算，本次非公开发行完成后，杨林先生控制的公司已发行股份的比例可能超过 30%。

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定，杨林先生参与认购本次非公开发行的股份将可能触发其向全体股东发出要约收购的义务，鉴于其参与认购不会导致公司控制权的变化，且杨林先生承诺在触发要约收购义务的情形下将根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第(一)项或届时最新监管规定对其认购的本次非公开发行的股份进行锁定，根据证监会《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第(一)项的规定，经公司股东大会非关联股东的批准，可以免于以要约方式增持公司股份。

关联董事杨林先生回避表决。

公司独立董事对该项关联交易进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于非公开发行募集资金运用的可行性分析报告的议案》

根据《管理办法》第四十条的规定，上市公司申请发行证券，董事会应就本次募集资金使用的可行性报告作出决议。针对本次非公开发行，公司编制了《惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《管理办法》第四十条的规定，上市公司申请发行证券，董事会应当就前次募集资金使用的报告作出决议，及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》第二条的规定，上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(境内或境外)募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准等相关要求，公司编制了《惠州中京电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(以下简称“《前次募集资金使用情况报告》”)。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》(天健审〔2020〕2-26 号)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31 号)等有关规定的要求，为保障中小投资者利益，维护中小投资者利益，公司编制了《惠州中京电子科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 [2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监发[2013]43 号)及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》等相关规定，公司制定了《惠州中京电子科技股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

为保证本次非公开发行高效、顺利地进行，公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会，在符合法律、法规和规范性文件的有关规定的情况下，全权办理本次非公开发行的有关事宜，具体如下：

1、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次非公开发行的具体方案；

2、根据股东大会审议通过的本次非公开发行的发行方案、中国证券监督管理委员会中国证券监督管理委员会核准意见及市场情况，与保荐机构(主承销商)协商确定本次非公开发行的具体发行时间、发行询价对象、最终发行数量、具体发行价格、募集资金规模、发行对象的选择等相关事宜；

3、办理本次非公开发行的申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、补充递交、呈报、执行和公告本次非公开发行的相关申报文件及其他法律文件；

4、在本次非公开发行完成后，根据本次非公开发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程的相关条款，并办理相关工商变更登记等有关事宜；

5、在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市等相关事宜；

6、除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据上市公司非公开发行 A 股股票的政策变化及审批机关和监管机构对本次非公开发行申请的审核意见或要求，对本次非公开发行的发行方案进行调整；

7、签署本次非公开发行募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及上报文件，指定或设立本次非公开发行的募集资金专项存储账户；

8、决定并聘请本次非公开发行的保荐机构等中介机构，制作、修改、签署与本次非公开发行有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、中介机构聘用协议等；

9、根据有关部门要求和市场的实际情况，在股东大会授权范围内对本次非公开发行募集资金投资项目及具体安排进行调整；

10、根据中国证券监督管理委员会对证券公司股东的相关资格要求，对拟认购本次非公开发行的投资者资格进行审核和筛选；

11、办理与本次非公开发行有关的其他事项。

上述第 4 至 5 项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其余授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2020 年第一次临时股东大会，《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 6 日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2020-011
债券代码：124004 债券简称：中京定转
债券代码：124005 债券简称：中京定 02

惠州中京电子科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设和前提

本次非公开发行实施完成后，在公司股本和净资产均增加的情况下，如果未来公司业务未获得相应幅度的增长，公司每股收益和加权平均净资产收益率将面临下降的风险。

考虑上述情况，公司基于下列假设条件对主要财务指标进行了测算，以下假设仅为测算本次非公开发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对未来年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况和公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下：

1、假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化；

2、为最大限度考虑摊薄即期回报对财务指标的影响，假设本次非公开发行于 2020 年 9 月底实施完毕，该完成时间仅为测算的假设时间，最终以中国证监会核准本次发行后的实际发行完成时间为准；

3、为量化分析本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响，假设本次非公开发行数量为 118,000,000 股，募集资金总额为 120,000 万元，同时，本次测算不考虑发行费用的影响，最终发行数量和募集资金总额以经中国证监会核准的情况为准；

4、根据公司 2019 年度业绩快报，2019 年末归属于公司股东的净资产初步核算为 137,176.33 万元，2019 年度归属于公司股东的净利润初步核算为 15,870.90 万元，假设扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润也为 15,870.90 万元；

5、假设 2020 年归属于公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润分别有以下三种情况：(1)与 2019 年度持平；(2)较 2019 年度增长 10%；(3)较 2019 年度增长 20%；

6、在预测公司发行后总股本时，以 2019 年末公司总股本 396,158,821 股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素(如资本公积转增股本、股权激励、期权激励行权、股票回购注销等)对本次公司股本总额的影响。

(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

项目	2019 年度/2019.12.31	2020 年度/2020.12.31	
		发行前	发行后
总股本(股)	396,158,821	396,158,821	514,158,821
假设情形(1):2020 年净利润年较 2019 年度保持不变			
归属于公司股东的净资产(万元)	137,176.33	153,047.23	273,047.23
归属于公司股东的净利润(万元)	15,870.90	15,870.90	15,870.90
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润(万元)	15,870.90	15,870.90	15,870.90
基本每股收益(元/股)	0.42	0.40	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	0.40	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.40	0.37
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.42	0.40	0.37
加权平均净资产收益率	14.58%	10.94%	9.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	14.58%	10.94%	9.06%
假设情形(2):2020 年净利润年较 2019 年度增长 10%			
归属于公司股东的净资产(万元)	137,176.33	154,634.32	274,634.32
归属于公司股东的净利润(万元)	15,870.90	17,457.99	17,457.99
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润(万元)	15,870.90	17,457.99	17,457.99
基本每股收益(元/股)	0.42	0.44	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	0.44	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.44	0.41
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.42	0.44	0.41
加权平均净资产收益率	14.58%	11.97%	9.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	14.58%	11.97%	9.92%
假设情形(3):2020 年净利润年较 2019 年度增长 20%			
归属于公司股东的净资产(万元)	137,176.33	156,221.41	276,221.41
归属于公司股东的净利润(万元)	15,870.90	19,045.08	19,045.08
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润(万元)	15,870.90	19,045.08	19,045.08
基本每股收益(元/股)	0.42	0.48	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	0.48	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.48	0.45
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.42	0.48	0.45
加权平均净资产收益率	14.58%	12.98%	10.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	14.58%	12.98%	10.78%

注：基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算

通过上述测算，不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营业绩、财务状况的影响，本次非公开发行完成后，公司的每股收益、加权平均净资产收益率可能下降，公司面临即期回报被摊薄的风险。

二、对本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行完成后，募集资金将显著的增加公司股东权益，但募集资金投资项目实施并产生效益需要一定周期，募集资金投资项目预期利润难以在短期内释放，股本规模及净资产规模的扩大可能导致公司的每股收益被摊薄。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险，虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

三、本次非公开发行的必要性与合理性

(一)本次非公开发行募集资金投资项目建设的必要性

1、紧抓 5G 通信等下游新兴应用领域的发展机遇，提升核心产品竞争力和公司市场地位

近年来，电子信息产业蓬勃发展、技术升级层出不穷，从而对 PCB 产品的工艺标准、技术参数、产品品质等各方面提出了新的要求。在通信代际更迭、数据流量爆发式增长的背景下，5G 通信网络的建设及 5G 产品的应用已成为 PCB 行业发展的催化剂，也势必带动对 5G 通信基站与基站天线、高性能服务器、5G 网络交换机、路由器、光传送网等通信设备和 5G 智能终端产品的高速增长。同时，随着 5G 通信在高清显示、云计算、人工智能、无人驾驶、物联网等应用领域的商用进程加快，催生的通信、计算和存储需求也会越来越旺盛。

以 5G 通信为例，5G 的高频高速、高性能、低延迟与高容量特性，将带动 5G 终端产品朝着高频高速、高度集成、轻薄化、智能化发展，从而使得 PCB 的孔径越来越小，纵横比越来越大，阻抗控制要求越来越严，布线密度越来越高，背钻孔间走线等节省空间的设计越来越多，对低损耗及高频高速材料的应用越来越广泛，对高速高多层 PCB、高阶高密度互联板(HDI & Any Layers HDI)以及对三维封装及空间节省要求较高的刚柔结合板(R-F)、类载板(SLP)等工艺产品的需求将大幅提升。

目前，受制于原有场地设计、产能等限制，公司多层板产品的平均层数仍受到一定限制，HDI 以及刚柔结合板的业务比重依然有较大提升空间，公司需进一步加快生产的智能化产线布局、加大在蚀刻、对位层压、钻孔、电镀、蚀刻、阻焊等重点工艺环节的高精密度和更高性能的设备、设施投入，提升产品层阶和生产工艺标准，从而抓住 5G 等下游新兴应用领域发展机遇。

公司通过实施本次募投项目建设智能制造工厂，采用高精密度生产设备、智能化系统，能够满足 5G 通信、新型高清显示、汽车电子、人工智能、物联网以及大数据、云计算等新兴应用领域对 PCB 产品的高层阶和高工艺标准，从而提升公司的核心竞争力和市场地位。

2、扩大产能规模、解决产能瓶颈，实现 PCB 主业的做大做强

公司现有的产能主要来源于 2014 年竣工的 IPO 募投项目以及之前的项目建设。近年来，随着公司 PCB 主营业务收入的持续快速增长，公司产能利用率已接近饱和：2016 年、2017 年、2018 年公司营业总收入增幅分别达到 37.26%、35.55%、63.61%，产能利用率超过 90%。虽然公司通过利润滚动投入，持续进行小规模的技术改造、设备升级，但产能的增幅相对有限。随着下游新兴应用领域的蓬勃发展、客户合作的不断深入，客户的单批次订单量不断上升，公司现有的产能将无法持续满足下游客户批量订单的新增需求。

通过实施本次募投项目，有助于进一步扩大公司经营规模，缓解目前产能接近饱和的局面，强化公司与大客户战略粘性，满足公司业务持续发展的需要，实现 PCB 主业的做大做强。

3、新建智能制造数字化工厂提升自动化、信息化水平，提高生产效率及盈利水平

根据国内外 PCB 龙头企业的历史发展经验，优化产线布局、提升生产与控制系统的智能化水平，是节约劳动力和物料，提高产品良率，实现高效成本控制和提升生产效率的有效措施。近年来，随着用工成本的提升以及上游原材料价格的波动，PCB 制造企业的成本控制、效率提升压力日益紧迫。

公司现有工厂筹建时间较早，虽然近年来通过持续的项目技改、管理改善，公司在成本控制、人工效率、产品毛利方面均有一定幅度的提升，但受制于工厂架构及布局，升级改造空间相对有限。目前，相较于国内较多 PCB 上市公司在 2016 年-2019 年新建工厂，公司现有工厂在智能化设计、精密化设备的配套、自动化、信息化以及数字化水平等方面存在一定的差距，从而导致公司生产成本相对较高，产品利润率相对偏低。

公司《中京电子基于工业互联网的印制电路板生产过程管控优化》项目已入围 2020 年惠州市工业互联网标杆示范项目，公司在智能制造、数字化生产等方面已有一定的技术和管理经验积累。公司通过实施本次募投项目建设智能制造数字化工厂，能够进一步有效提高生产效率，从而进一步改善公司的盈利水平，实现公司经营效益的持续稳步提升。

(二)本次非公开发行募集资金投资项目建设的合理性

1、公司具有良好的生产工艺基础和高端制造能力

公司在 PCB 领域深耕二十年，通过不断的经验积累、技术改进，具有良好的生产工艺基础和高端制造能力。公司系中国电子电路行业协会(CPCA)副理事长单位，CPCA 行业标准制定单位之一，系工信部首批符合《印制电路板行业规范条件》的 PCB 企业，已通过工信部两化融合管理体系认证，并获得广东省知识产权优势企业、优秀电子电路行业名族品牌企业、惠州市工业互联网标杆示范项目、广东省 LED 封装印制电路板工程技术研究中心等资质及荣誉称号。

公司产品包括双面板、多层板、高密度互联板(HDI)、柔性电路板(FPC)、刚柔结合板(R-F)和柔性电路板组件(FPCA)，是目前国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的 PCB 制造商。以 HDI 和刚柔结合板为例：(1)在 HDI 方面，公司 HDI 项目(IPO 募投项目)自 2012 年开始投建，2014 年投产，产品已实现二阶、三阶大批量生产，并已具备更高阶及 Any-layer HDI 的批量生产能力，在高阶 HDI、精细线路、层间对位控制等关键性技术上达到国内较为领先的水平；(2)在刚柔结合板方面，公司全资子公司元盛电子、中京科技均具备刚柔结合板生产能力，并均已实现批量供货，但均受制于产能而无法承载客户大批量订单，无法实现较好的规模效益。

2、公司具有较强的新产品开发能力和新技术应用能力

公司长期重视并坚持技术创新和新产品开发，在内部设有技术委员会和专家委员会，拥有省级工程研发中心和企业技术中心、国家级博士后科研工作站。公司系广东省创新型企业、国家级火炬计划重点高新技术企业、2019 年全国电子信息行业创新企业，截至本预案公告日，已取得 20 项高新技术产品认定、20 项发明专利、51 项实用新型专利。

同时，公司积极借助外部的有利环境，加强与客户在新产品、新技术等方面的合作开发、同步开发，快速响应客户的需求变化，并与电子科技大学、华南理工大学、广东工业大学、华南师范大学等国内著名高校建立了稳定的产学研合作关系，推动新技术、新产品的产业化。

针对本次募投项目所涉及的新产品，公司已经具备较为成熟的技术储备和良好的产品开发能力：(1)在 5G 通信配套领域，针对高速高频 PCB，公司已经完成了相关材料测试，提升了阻抗控制、对准度控制、纵横比制作能力和背钻技术的开发能力，公司已申请 5 项 5G 技术相关专利并已获得受理。公司在 5G 通信设备(光模块、服务器、路由器、Wifi、基站天线等)、5G 移动终端的配套 PCB 产品已处于配套开发、小批量生产阶段，部分产品已向客户批量供货生产；(2)在新型高清显示配套领域，公司系国内 LED/Mini LED 用 PCB 领域的龙头企业之一，被认定为广东省 LED 封装印制电路板工程技术研究中心，参与了《高亮度 LED 用印制电路板》等多项行业标准的制定，Mini LED 显示屏的封装基板关键技术处于国内较为领先的水平，小间距 LED 用 PCB 已实现大批量供货。

3、公司丰富的客户资源和较强的市场开拓能力，能够消化募投项目产能

经过长期的拓展和积累，凭借“技术创新、品质至上、用户满意”的经营理念，公司在行业内树立了良好的声誉和品牌形象，并积累了丰富的客户资源。

在 5G 通信领域，公司在 5G 通信设备和 5G 移动终端等方面均储备了丰富的客户资源，目前正积极进行产品开发、测试打样，部分产品已向客户小批量供货生产，其中：(1)在 5G 光模块、服务器、基站用 LCP 高频传输线方面，公司已完成样品生产，正进行材料可制造性、可靠性、电性能等方面的测试，即将进入小批量生产阶段；(2)在交换机、WiFi、路由器、5G Mifi 等网络通讯设备方面，公司正逐步实现小批量供货；(3)在移动智能终端方面，公司与华勤、闻泰、龙旗等国内主要知名的 ODM 厂商均保持长期稳定的合作关系，可快速实现产品导入；(4)在智能手机天线、新型显示、摄像头模组等领域，公司与京东方、深天马、硕贝德、信维通信、丘钛科技等保持良好的合作关系。

在新型高清显示领域，公司在小点间距 LED 配套等细分领域具有较强的竞争优势和客户认可度，在新兴的 Mini LED 配套领域也已实现了批量供货。目前，公司已与艾比森、洲明科技、国星光电、光祥科技、强力巨彩等多家知名 LED 厂商保持长期良好的业务合作。

在汽车电子领域，由于汽车电子系公司长期及拟重点发展的细分市场之一，公司已与比亚迪、华阳通用、康明斯等在流媒体、新能源电池管理模块、机电管理系统等应用领域保持良好的业务合作。

4、公司具有良好的经营管理经验，能够有效保证募投项目的成功实施

公司核心管理人员均拥有近 20 年 PCB 研发、生产、销售或服务等实务管理经验。近年来，公司坚持“改革、创新、高效”发展与管理思路，重点关注、学习和借鉴国内外先进企业的管理经验，持续提升管理运营效率和盈利能力。

近年来，公司持续开展了多项改革举措：(1)在人力资源方面，公司聘请了专业咨询机构对公司组织机构、职能模块、考核机制，人才的激励和晋升路径进行系统性的梳理和全面优化，公司实施了 2016 年度限制性股票激励计划和 2018 年度期权激励计划，并取得了良好激励效果；(2)在生产制造方面，公司持续引进业内高级技术与管理人才，吸收和借鉴行业先进企业的发展经验和方法，积极优化工艺流程，强化成本控制意识，提升生产效率和产品良率；同时引进外部专业机构积极辅导“精益生产”体系，以从各环节提高制造与品质系统的精细管理能力，为降低成本提升制程效益做出了实质性改善；(3)在信息化建设方面，公司全面优化升级 OA 系统、HR 系统、CRM 系统、ERP 系统，并已开展 MES、EAP、APS、WMS 等系统的选型与方案设计，以保障珠海募投项目工厂的柔性与数字化制造能力，并积极持续推进公司制程智能化与工业互联网改造项目。

综上所述，公司核心管理人员多年来积累了丰富的经营管理经验，能够有效保障企业生产经营的有序进行以及本次募投项目的成功实施。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于公司优化产品结构和巩固市场地位，对公司扩大产能、丰富公司业务结构及产品品种、寻求新的利润增长点、提升持续盈利能力具有重要意义。本次发行不会导致公司的主营业务发生变化。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人才储备情况

在人员和技术方面，公司历来重视人才培养和储备，经过多年发展已经形成一支高素质的核心管理团队和优秀的技术团队。管理人员之间分工明确，对公司未来发展拥有共同理念，并形成了团结、高效、务实的经营管理风格。在日常生产经营中，公司核心管理团队注重质量控制和成本管理，确保产品的市场竞争力，不断开拓市场，有效提升了公司的市场知名度。同时，公司拥有一支业务能力强、专业程度高的研发队伍，技术骨干均长期从事印制电路板领域相关生产技术的研究、开发工作，在印制电路板领域具备丰富的经验。

2、技术储备情况

公司自成立以来坚持以科技创新为导向，依靠科技进步保持持续发展，公司十分重视研发投入。公司拥有多项专利与非专利技术，技术研发实力雄厚。同时公司通过不断引进先进的研发、生产和检测设备，提高研发生产能力，保证了公司在行业内的研发生产优势。公司在